

2019年9月2日
株式会社ピーバンドットコム

(訂正) 「最大 100 層まで！5G で需要拡大する超高多層基板の受付を開始」
の一部訂正について

当社が、2019年9月2日(月)12:00に発表いたしました開示資料において、下記のとおり訂正がありましたのでお知らせいたします。

記

1. 訂正の内容： リリース日の訂正

(訂正前)

2018年9月2日

(訂正後)

2019年9月2日

以上

本件に関するお問い合わせ先： 株式会社ピーバンドットコム IR 担当

電話番号：03-3265-0343 E-mail：ir@p-ban.com

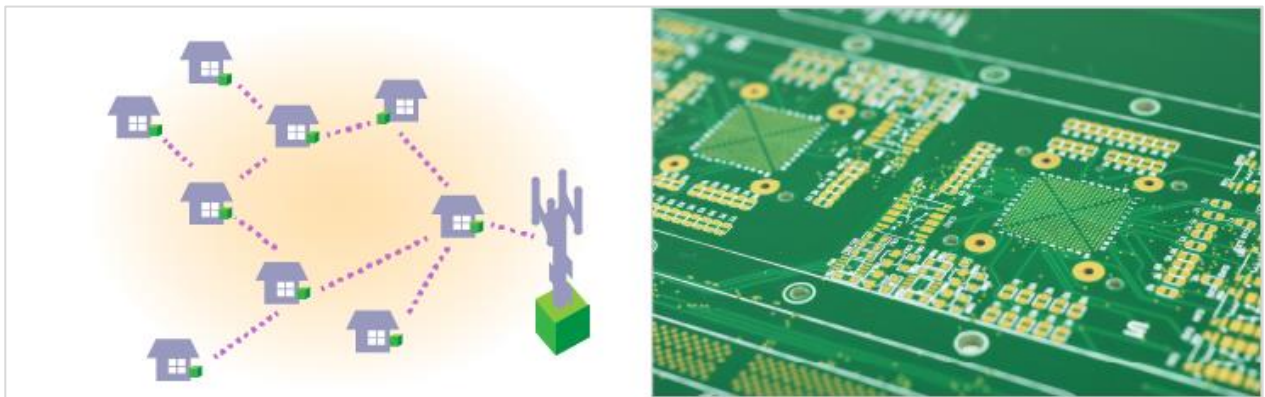
報道関係者各位
プレスリリース

2019年9月2日
株式会社ピーバンドットコム

最大 100 層まで！5G で需要拡大する超高多層基板の受付を開始

株式会社ピーバンドットコム（本社：東京都千代田区、東証マザーズ上場 3559）は、8月26日より、当社が運営するプリント基板のネット通信販売サイト「P板.com（ピーバンドットコム）」において、超高多層基板の受付を開始いたしました。

超高多層基板は、主に社会インフラ向け基板として注目されており、たとえばスマートフォンや自動運転などの利用において普及が期待される5G（第5世代移動通信システム）に対応する基地局向けベアバンド基板、IoTの拡大に伴う無線通信とバックプレーン用基板、そしてレーダーなど高速ギガ帯通信用途の基板として用いられます。



内閣府が提唱する「Society 5.0」の実現に向け、5Gの普及が期待されている

当社では、これまでのお客様からのお問い合わせや、市場ニーズの調査から、今後の需要拡大を見込み、このたび超高多層基板の受付を開始することといたしました。

6層基板、8層基板はもちろん、層数、板厚等の高い設計自由度により、最大100層の超高多層基板を1枚から、イニシャル費用無料にて、圧倒的なコストメリットで提供いたします。

また、国内外の充実した製造工場のネットワークを生かし、お客様が求める製造仕様、ご希望納期、そして製造ボリュームにマッチした最適な工場を選定し、安心のモノづくりを実現しております。

田坂正樹代表取締役は「通信デバイスの高機能化によって、超高多層基板の需要が拡大しております。

特にいま世界で開発がすすめられている 5G の実用化に向けては、超高多層基板の利用が不可欠であり、5G 関連製品は今後大きな伸長が期待されます。新しい社会の創出の一助として、P 板.com の高多層基板が貢献できることを期待しております。」と述べています。

当社は、「開発環境をイノベーションする」を経営スローガンに、これからもお客様のユーザビリティの向上に努めてまいります。

■関連リンク

◆高多層基板製造サービス <https://www.p-ban.com/product/multilayer.html>

■お問い合わせ先： 株式会社ピーバンドットコム IR 担当

電話番号：03-3265-0343 E-mail：ir@p-ban.com